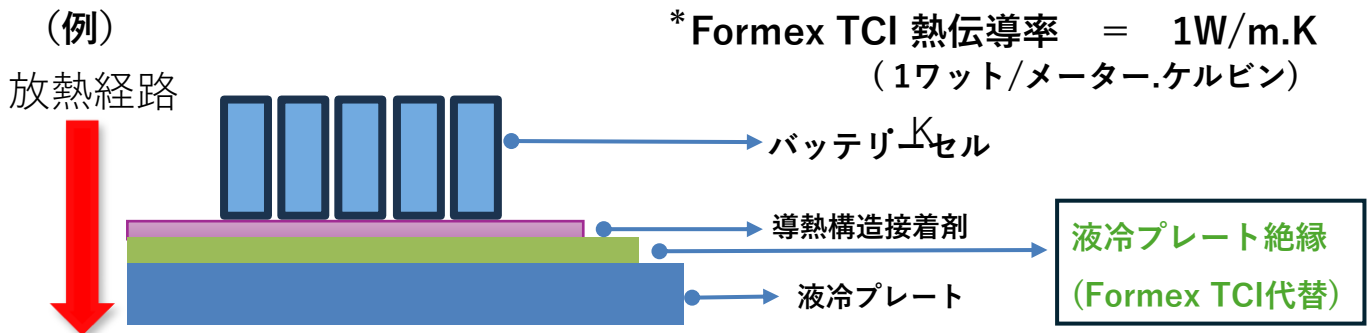


「絶縁材の熱伝導率に依る回路お及びICへの影響」

Formex TCI (Thermal Conductive Insulator)

バッテリー・アダプターやコンバーター等には、密閉された狭いスペースに、IC等の電子部品が組み込まれており、内部温度上昇に対する考慮が必要とされます。その際、使用される絶縁材に依っては、内部温度上昇に違いを生じる場合が多々有ります。



液冷プレート絶縁部の熱伝導率が低いと、放熱経路に高い熱抵抗が存在し、全体的な放熱効果を制約してしまう。

- ・ 効果
 - クイック充電と熱放熱の課題を最適化する。
 - シンプルなプロセスと高い絶縁性。
 - 低エネルギー消費・省エネで環境に優しい。
 - セルの稼働温度を低減し、寿命を向上させる。
 - 各種電子部品の昇熱緩和。

	一般的な絶縁材使用	Formex TCI 使用
A 温度範囲120°CのIC使用区	121.9 °C	113.5 °C
B 温度範囲125°CのIC使用区	123 °C	111.2 °C

一般的な絶縁材を使用した場合、

例 Aでは、温度範囲を超え、この絶縁材は温度設計要件を満たしません。

例 Bでは、ぎりぎりの範囲で使用する事になり、リスクを負います。